

アルゴン・窒素等のガスを一切必要としないエアー方式による『大気圧エアープラズマ装置』 販売開始のお知らせ

【株式会社ウェル】

テストチップをコアとした半導体先端実装ソリューションプロバイダーの株式会社ウェル（所在地：東京都品川区、代表取締役：江田尚之）は、アルゴン・窒素等のガスを一切必要とせず、エアーのみで超高密度ラジカルを発生させる大気圧エアープラズマ装置の日本国内販売を開始しました。

本装置は海外市場において、すでに400台以上の納入実績がございます。

従来のアルゴンプラズマ装置に比べて、高速処理と低ランニングコストを兼ね備えた経済性とダメージフリープラズマが最大の特徴です。

□特徴

- ・ 超高密度ラジカル発生
- ・ ポテンシャルフリープラズマ（微細配線パターン上へ直接プラズマ照射可能）
- ・ 高速処理（従来比3倍～10倍以上）
- ・ 低ランニング費用（アルゴン・窒素ガス不要、電源AC100V仕様）

□主な用途

- ・ ワイヤーボンディング前処理
- ・ 半導体パッド部めっき前処理
- ・ ダイボンディング前処理
- ・ 超音波接合前処理
- ・ 樹脂封止前処理
- ・ タッチパネルのラミネートフィルム貼付工程
- ・ 各種材料の表面改質（親水化、疎水化処理）
- ・ 液晶基板の端子洗浄
- ・ FPC基板の表面改質
- ・ ビルドアップ基板のスルーホール洗浄

◆カタログ申込はこちら

<https://ssl.form-mailer.jp/fms/06365125132895>

株式会社ウェル

実装ソリューション営業部

〒140-0002 [東京都品川区東品川2-2-25](#) サンウッド品川天王洲タワー2F

tel : 03-5715-3501

fax : 03-5715-3502

mail : info@welljp.co.jp

【会社案内】

<http://www.welljp.co.jp/>

【大気圧プラズマ表面改質装置】

<http://well-plasma.jp/>

【先端実装開発用TEGチップ】

<http://well-teg.jp/>

【フリップチップ実装受託&バンプ加工サービス】

<http://well-jisso.jp/>

【LED実装受託&LED関連製品】

<http://well-led.jp/>

Generated by ふれりりプレスリリース

<https://www.prerele.com>